

フリップチップボンダ

BP1000LS
Flip chip bonder

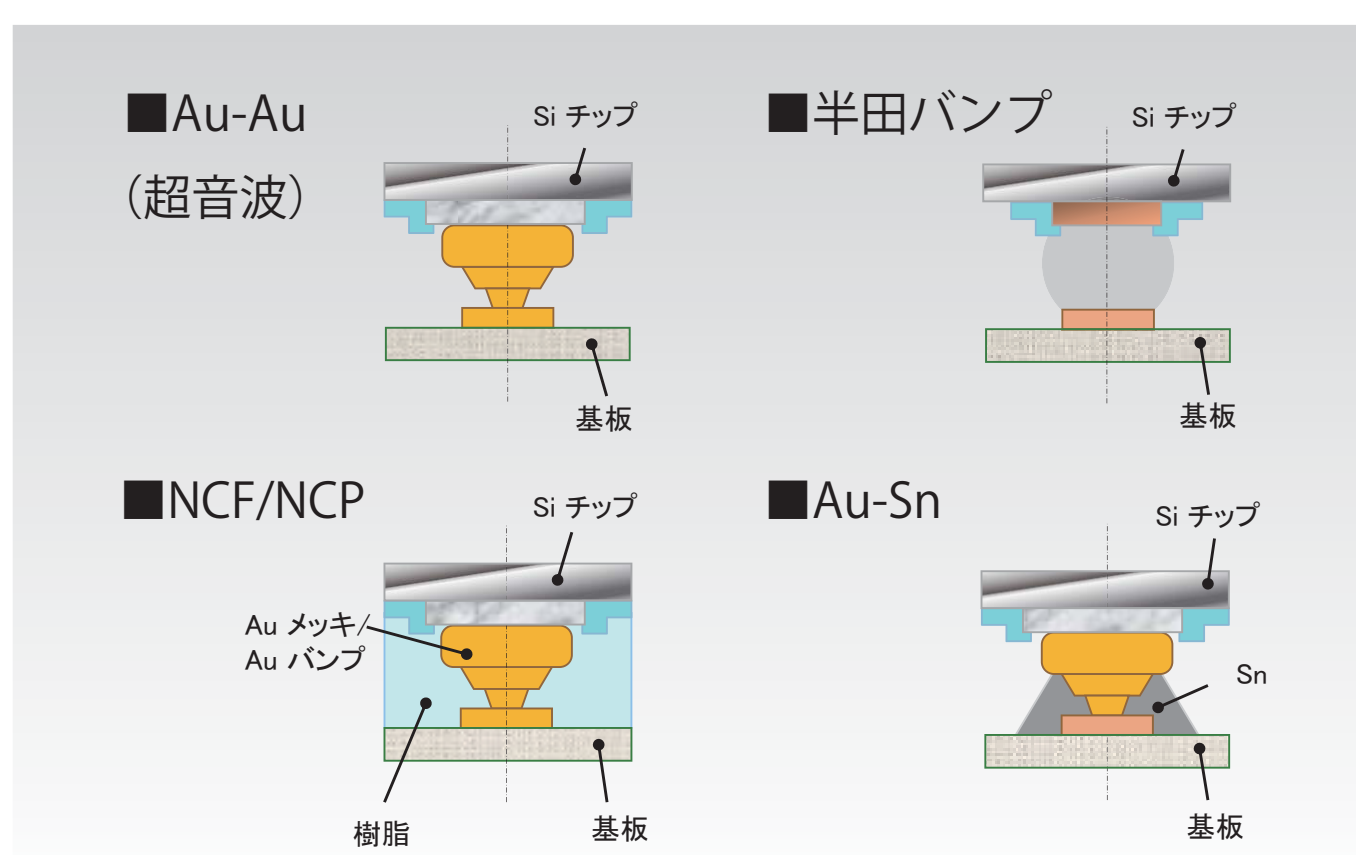
半導体の高精度実装に最適なフリップチップボンダ



ヘッド荷重	荷重 50 ～ 1000N
ヘッド種類	超音波ヘッド（ヒータヘッド、マウントヘッドに交換可）
超音波周波数	周波数：30 k Hz/40 k Hz/50 k Hz から選択
ヘッド制御	荷重、位置、超音波のデジタル制御
アライメント精度	±5μm
有効ワークエリア	□200mm
接合モニタリング	プロファイル参照ソフト標準搭載
レシピ	接合条件：デジタル設定
ユーティリティ	空圧源 0.5MPa ドライエアー
	電 源 本体 200V50A
ユニットサイズ	W1190×D1090×H1650mm（本体部）
ユニット重量	800kg

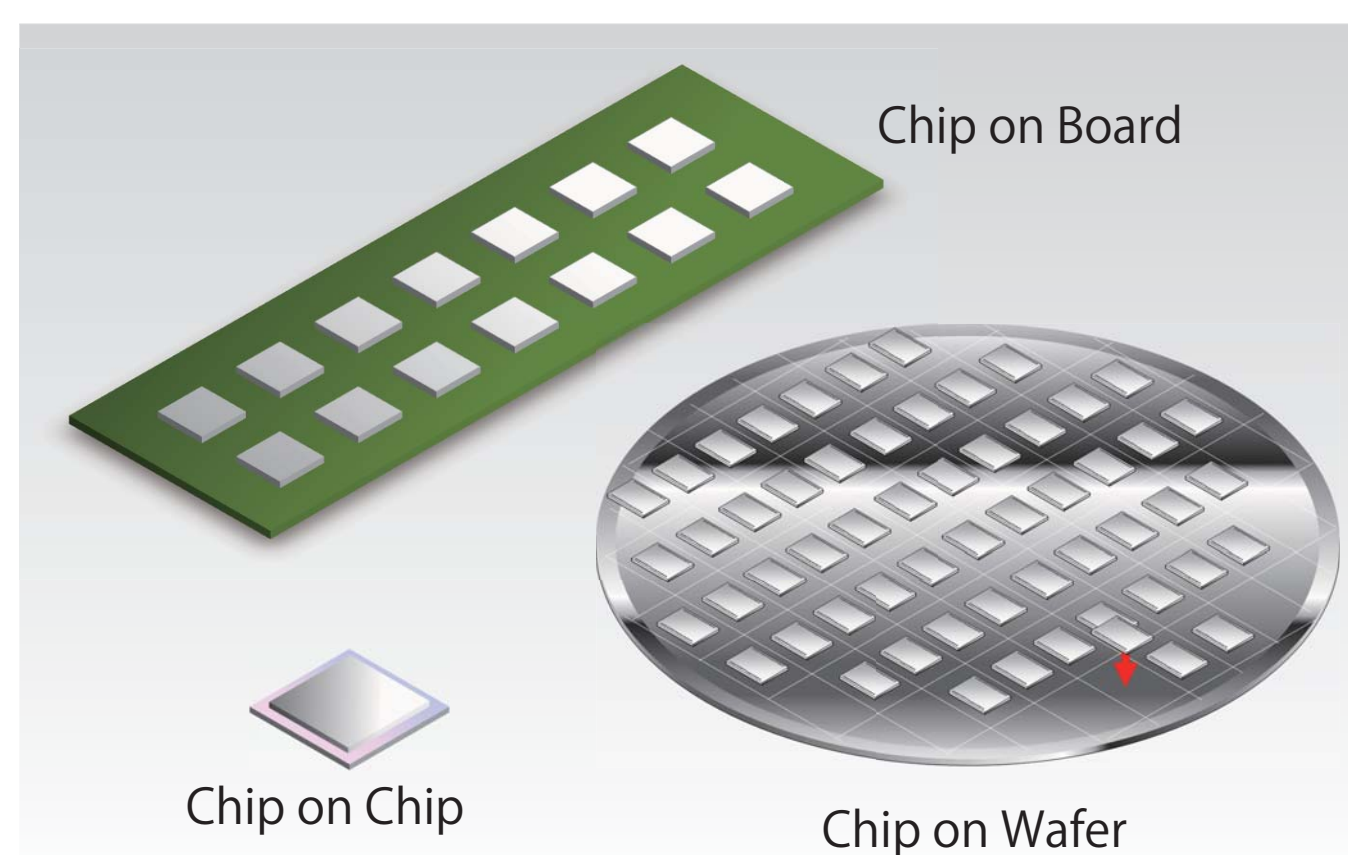
アプリケーション

●接合プロセス事例



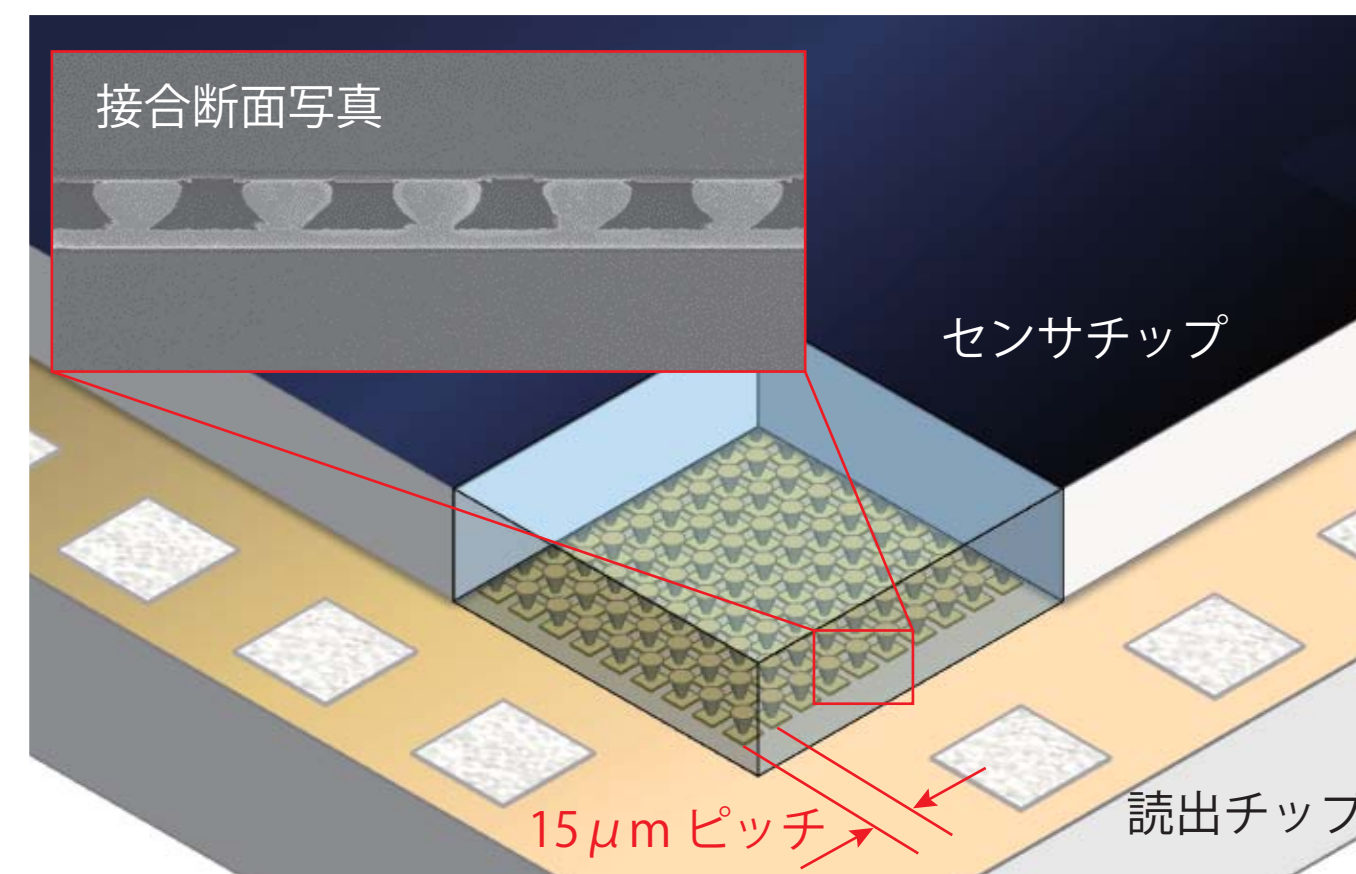
各種接合プロセスに対応

●実装形態事例



ユーザーニーズに合わせてカスタマイズ

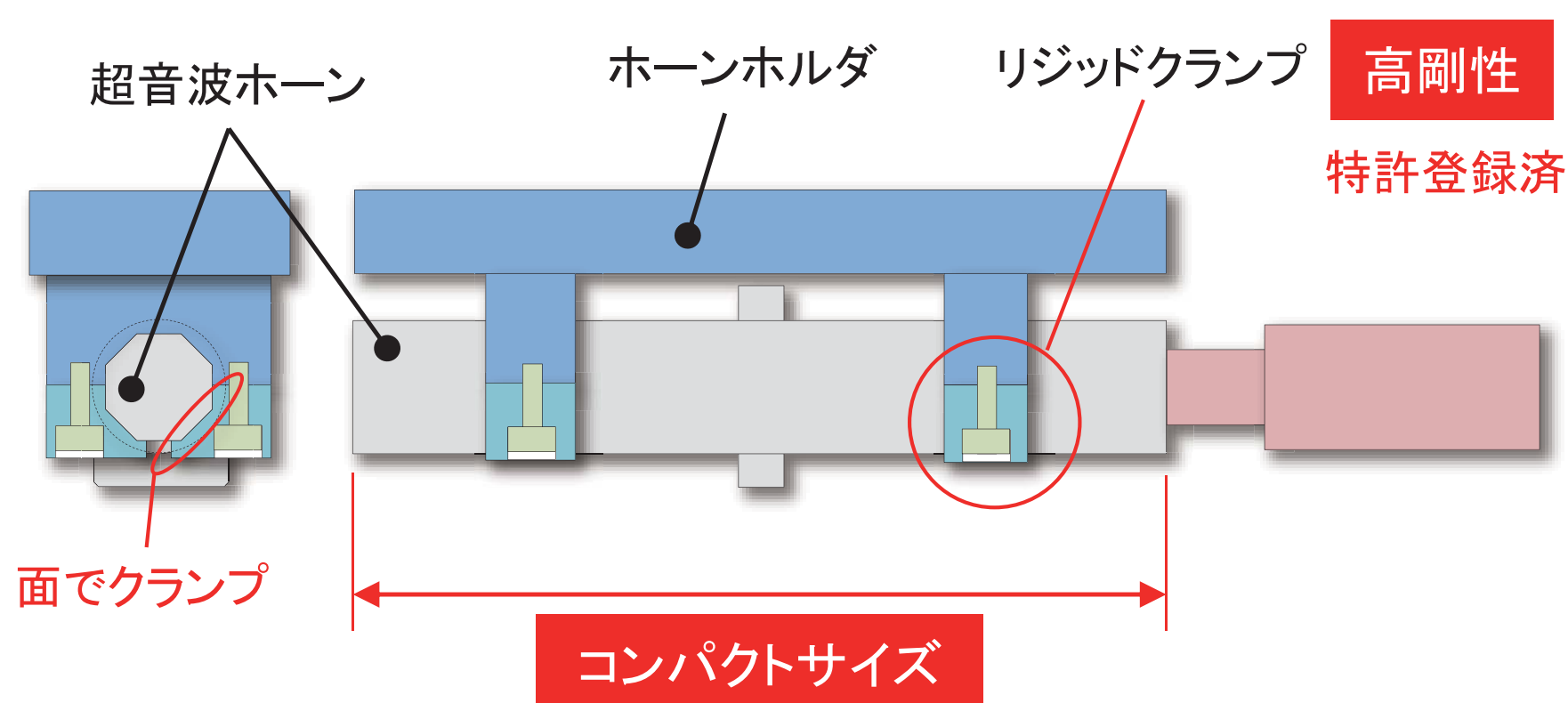
●15μm ピッチ 30 万バンプ実装事例



15μm ピッチデバイスを超音波接合

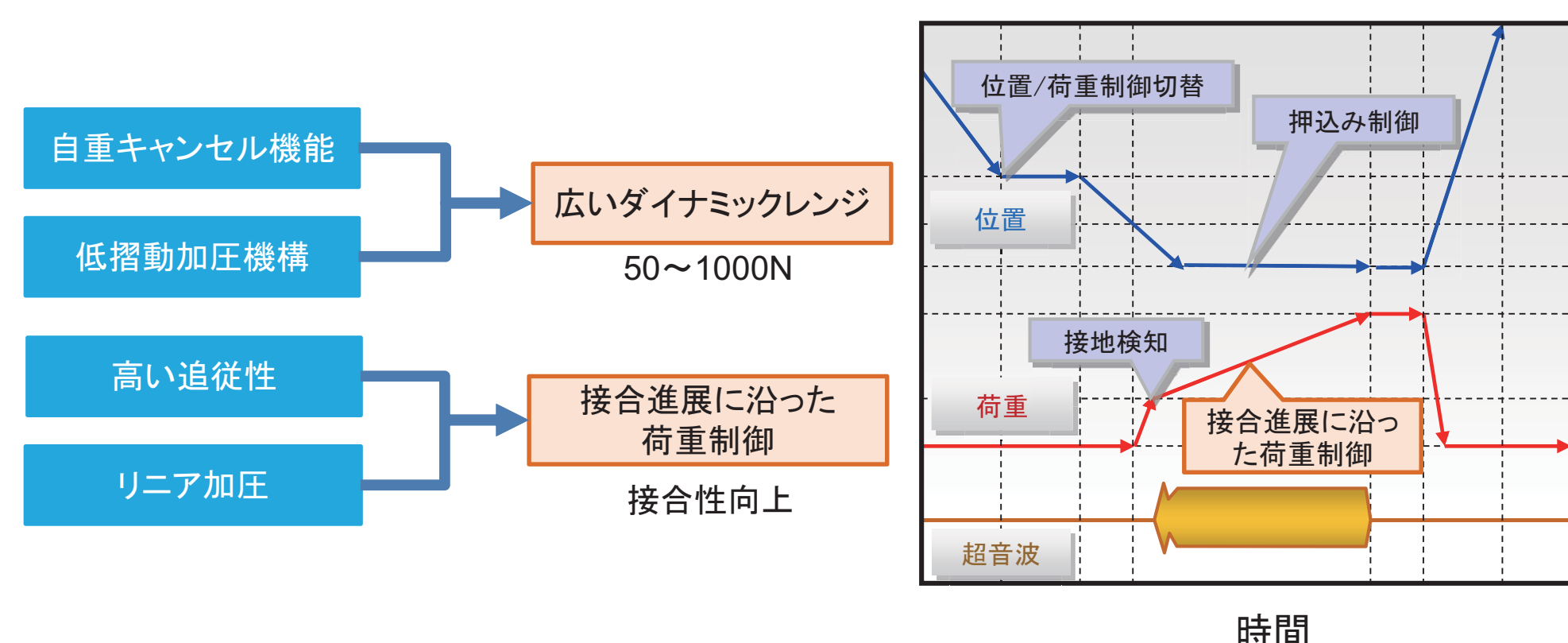
高剛性ホーンクランプ機構

【リジッドクランプ】によって、超音波ホーンをダイレクトにクランプ。高剛性クランプにより高荷重でも高い平面度を確保。



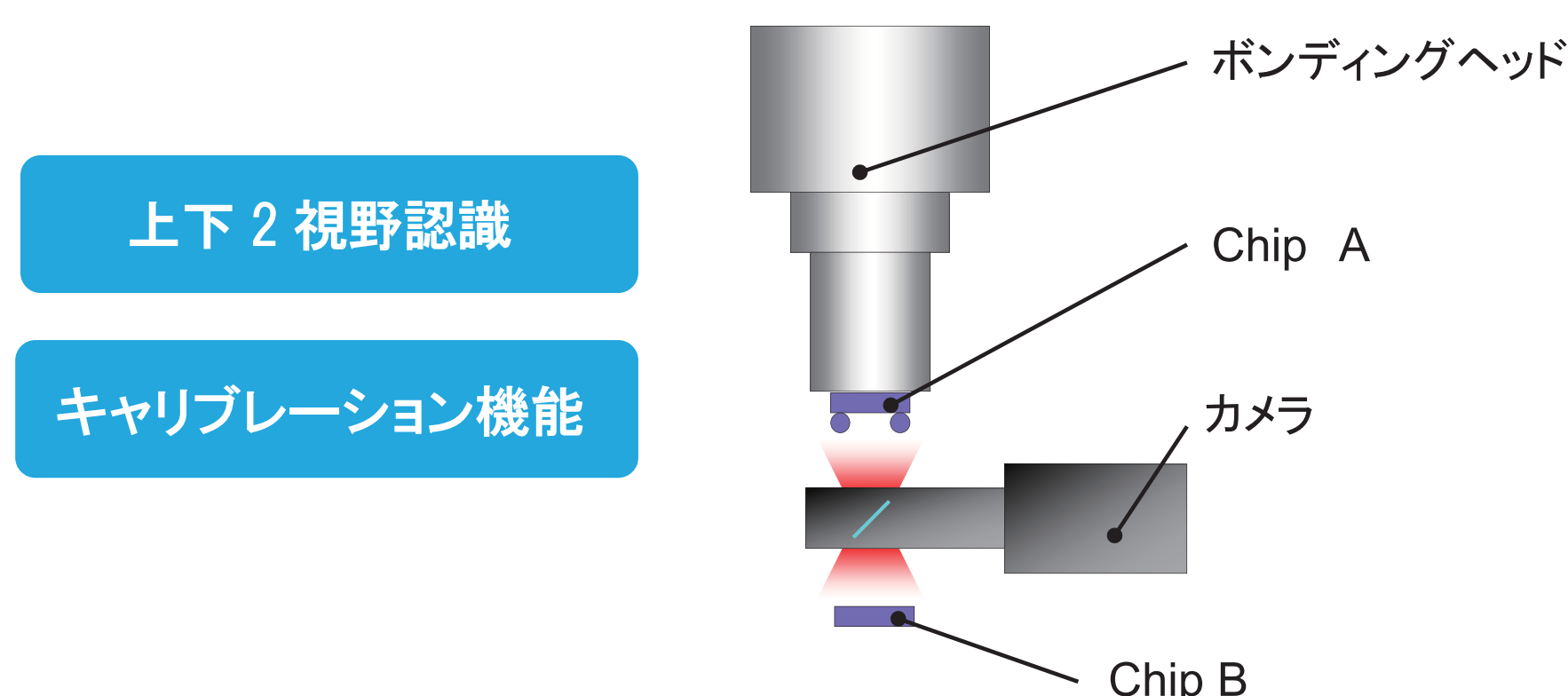
高機能位置荷重制御

低摺動加圧機構による広いダイナミックレンジを実現。接合時の変形に高い追従性を持ち、接合進展と共に荷重を上げるリニア加圧でにより接合性が向上。



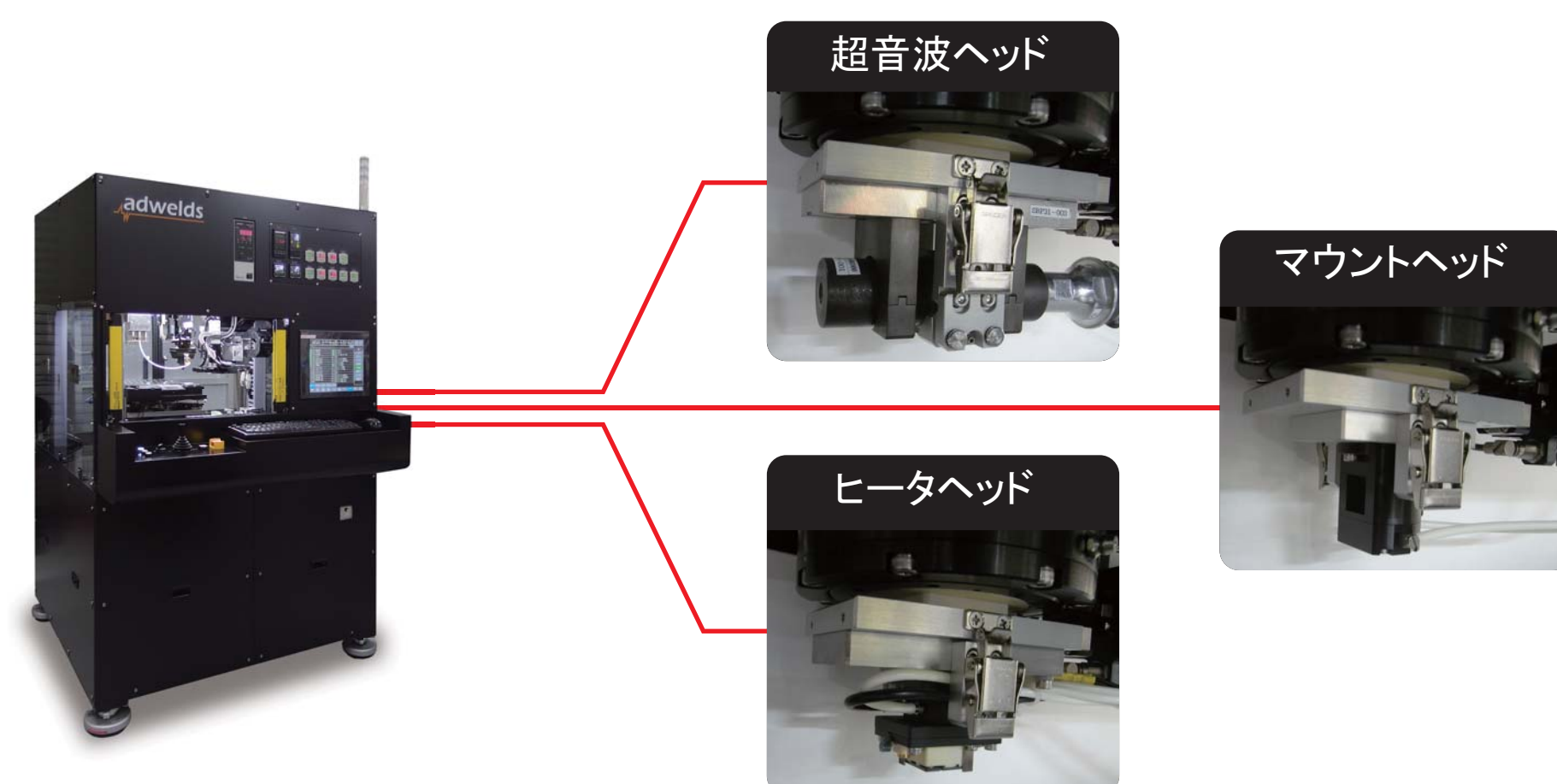
高精度アライメント

上下2視野認識に加え、経時変化を補正する【アライメントキャリブレーション機能】を搭載。安定した高精度実装を実現。



ヘッド交換で各種プロセスに対応

接合プロセスに合わせて、容易にヘッド交換が可能。御要望にマッチする各種ヘッドをラインナップ。



株式会社アドウェルズ
福岡 本社
東京営業所
名古屋テクニカルセンター

<http://www.adwelds.com> Mail info@adwelds.com
〒811-1201 福岡県那珂川市片縄8丁目140番地
〒140-0004 東京都品川区南品川5丁目10番45号
〒463-0018 愛知県名古屋守山区桜坂4丁目206番地
なごやサイエンスパーク 先端技術連携リサーチセンター内

TEL 092-555-6000
TEL 03-6433-9920